

2020-2026年中国集成电路 封装市场深度评估与投资策略报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国集成电路封装市场深度评估与投资策略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202006/169118.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录第1章：中国集成电路封装行业发展背景1.1 集成电路封装行业定义及分类1.1.1 集成电路封装界定1.1.2 集成电路封装行业产品分类1.1.3 集成电路封装行业特性分析1.2 集成电路封装行业政策环境分析1.2.1 行业管理体制1.2.2 行业相关政策1.3 集成电路封装行业经济环境分析1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析1.3.3 居民收入与行业的相关性1.4 集成电路封装行业技术环境分析1.4.1 集成电路封装技术演进分析1.4.2 集成电路封装形式应用领域1.4.3 集成电路封装工艺流程分析1.4.4 集成电路封装行业新技术动态 第2章：中国集成电路产业发展分析2.1 集成电路产业发展状况2.1.1 集成电路产业简介2.1.2 集成电路产业发展现状2.1.3 集成电路产业三大区域分析2.1.4 集成电路产业面临挑战、发展途径以及发展前景2.1.5 集成电路产业发展预测2.2 集成电路设计业发展状况2.2.1 集成电路设计业发展概况2.2.2 集成电路设计业行业发展现状2.2.3 集成电路设计业行业政策分析2.2.4 集成电路设计业发展策略分析2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测2.3 集成电路制造业发展状况2.3.1 集成电路制造业发展现状分析2.3.2 集成电路制造行业规模及财务指标分析2.3.3 集成电路制造行业供需平衡分析2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测 第3章：中国集成电路封装行业发展分析3.1 中国集成电路封装行业发展历程3.2 中国集成电路封装行业发展现状3.2.1 集成电路封装行业规模分析3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测3.3 半导体封测发展情况分析3.3.1 半导体行业发展概况3.3.2 半导体行业景气预测3.3.3 半导体封装发展分析3.4 集成电路封装类专利分析3.4.1 专利发展情况分析3.5 集成电路封装过程部分技术问题探讨3.5.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策3.5.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策 第4章：中国集成电路封装市场产品及需求分析4.1 集成电路封装行业主要产品分析4.1.1 BGA产品市场分析4.1.2 SIP产品市场分析4.1.3 SOP产品市场分析4.1.4 QFP产品市场分析4.1.5 QFN产品市场分析4.1.6 MCM产品市场分析4.1.7 CSP产品市场分析4.1.8 其他产品市场分析4.2 集成电路封装行业市场需求分析4.2.1 计算机领域对行业的需求分析4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析4.2.6 医疗电子领域对行业的需求分析 第5章：集成电路封装行业市场竞争分析5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析5.1.4 国际集成电路封装行业扶持措施借鉴5.2 跨国企业在华市场竞争力分析5.2.1 台湾日月光集团竞争力分析5.2.2 美国安靠（Amkor）公司竞争力分析5.2.3 台湾矽品公司竞争力分析5.2.4 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析5.2.5 力成科技股份有限公司竞争力分析5.2.6 飞思卡尔公司竞争力分析5.2.7 英飞凌科技公司

竞争力分析5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析5.3.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析5.4 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析5.4.1 现有竞争者之间的竞争5.4.2 上游议价能力分析5.4.3 下游议价能力分析5.4.4 行业潜在进入者分析5.4.5 替代品风险分析5.4.6 行业竞争五力模型总结 第6章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析6.1 集成电路封装企业发展总体状况分析6.2 集成电路封装行业领先企业个案分析6.2.1 上海华岭集成电路技术股份有限公司经营情况分析6.2.2 山东齐芯微系统科技股份有限公司经营情况分析6.2.3 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司经营情况分析6.2.4 南通华隆微电子股份有限公司经营情况分析6.2.5 上海芯哲微电子科技股份有限公司经营情况分析6.2.6 深圳电通纬创微电子股份有限公司经营情况分析6.2.7 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析6.2.8 苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析6.2.9 天水华天科技股份有限公司经营情况分析6.2.10 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析6.2.11 苏州固得电子股份有限公司经营情况分析6.2.12 星科金朋（上海）有限公司经营情况分析6.2.13 大唐微电子技术有限公司经营情况分析6.2.14 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析6.2.15 安靠封装测试（上海）有限公司经营情况分析 第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议7.1 集成电路封装行业投资特性分析7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒7.1.2 集成电路封装行业盈利模式7.1.3 集成电路封装行业盈利因素7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析7.3 集成电路封装行业投融资分析7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析7.3.3 半导体行业资本支出分析7.4 集成电路封装行业投资建议7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析7.4.3 集成电路封装行业投资建议 图表目录
图表1：封装在集成电路制造产业链中位置
图表2：集成电路封装行业产品分类
图表3：集成电路封装行业产品分类
图表4：集成电路封装产品按封装外形分类
图表5：2016-2019年江苏长电科技股份有限公司季度销售收入分布（单位：亿元）
图表6：集成电路封装行业主要政策分析
图表7：2016-2019年美国国内生产总值变化趋势图（单位：十亿美元，%）
图表8：2016-2019年欧元区GDP季度同比增长变化（单位：%）
图表9：2016-2019年日本实际GDP环比变化（单位：%）
图表10：2016-2019年中国国内生产总值情况及增长率（单位：亿元，%）
图表11：2016-2019年我国全部工业增加值增速（单位：亿元，%）
图表12：2016-2019年中国GDP增速与集成电路封装行业销售收入增速对比图（单位：%）
图表13：2016-2019年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图（单位：元，%）
图表14：2016-2019年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图（单位：元，%）
图表15：集成电路封装技术发展历程
图表16：集成电路封装技术示意图
图表17：集成电路封装技术应用领域
图表18：集成电路封装工艺流程
图表19：

集成电路产业链示意图
图表20：集成电路业务模式示意图
图表21：2016-2019年我国集成电路行业销售额增长情况（单位：亿元，%）
图表22：2016-2018我国集成电路行业进出口额情况分析（单位：亿块，亿美元）
图表23：2019年我国集成电路产业产值结构图（单位：%）
图表24：集成电路封装行业产业区域特征分析
图表25：集成电路封装行业产业区域特征分析图
图表26：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析
图表27：2020-2026年中国集成电路行业市场规模预测图（单位：万亿元，%）
图表28：2016-2019年国内集成电路设计市场销售收入和增长情况（单位：亿元，%）
图表29：2018国内销售前十大集成电路设计企业分析（单位：亿元）
图表30：集成电路设计行业政策分析
图表31：集成电路设计业新发展策略

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202006/169118.html>